

RMA-223, Rosin Mildly Active Solder Paste

Product Data Sheet

Product Highlights

- ROL0 flux classification
- Exceptional print definition
- Excellent wetting on most board finishes
- Low voiding
- Long stencil life
- Wide process window
- REACH compliant
- Compatible with enclosed print heads
- Print & dispense grade solder paste available

Available Alloys

Alloy	Temp °C	Temp °F
63Sn/37Pb	183	361
62Sn/36Pb/2Ag	179	354
62.8Sn/36.8Pb/0.4Ag	179-183	354-361
60Sn/40Pb	183-191	361-376
43Sn/43Pb/14Bi	144-163	291-325
42Sn/58Bi	138	280
10Sn/88Pb/2Ag	268-290	514-554

Packaging

500 gram jars
700 gram cartridges
35 or 100 gram syringes
ProFlow cassettes

Test Results

Test J-STD-004 or other requirements (as stated)	Test Requirement	Result
Copper Mirror	IPC-TM-650: 2.3.32	L: No breakthrough
Corrosion	IPC-TM-650: 2.6.15	L: No Corrosion
Quantitative Halides	IPC-TM-650: 2.3.28.1	L: <0.05%
Electrochemical Migration	IPC-TM-650: 2.6.14.1	L: <1 decade drop (No-cleaned)
Surface Insulation Resistance 85 °C, 85% RH @ 168 Hours	IPC-TM-650: 2.6.3.7	L: ≥100 MΩ (No Clean)
Tack Value	IPC-TM-650: 2.4.44	48g
Viscosity - Malcom @ 10 RPM/25 °C (x10 ³ mPa/s)- Sn63/Pb37 T3/T4	IPC-TM-650: 2.4.34.4	Print: 200-275 Dispensing: 110-150
Visual	IPC-TM-650: 3.4.2.5	Clear and free from precipitation
Conflict Minerals Compliance	Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)	Compliant
REACH Compliance	Articles 33 and 67 of Regulation (EC) No 1907/2006	Contains no substance >0.1% w/w that is listed as a SVHC or restricted for use in solder materials

RMA-223, Rosin Mildly Active Solder Paste

Printer Operation

The following are general guidelines for stencil printer optimization with RMA-223. Some adjustments may be necessary based on your process requirements.

Print Speed: 25-100 mm/sec

Squeegee Pressure: 70-250g/cm of blade

Under Stencil Wipe: Once every 10-25 prints, or as necessary

Stencil Life

> 8 hours @ 30-45% RH and 20-25 °C

~ 4 hours @ 45-75% RH and 20-25 °C

Cleaning

RMA-223 is a Rosin Mildly Active solder paste that can be left on the board for many SMT assemblies. For applications requiring cleaning, RMA-223 can be cleaned using flux residue removers such as Inventec Disper 607 and Disper 610.

Recommended Profile

This profile is designed to serve as a starting point for process optimization using RMA-223. To achieve better results with voiding or to reduce tombstoning, consider using a longer soaking zone, [140-180 °C] for 60-90 seconds, with a rapid pre-heat stage. If there is evidence of solder de-wetting, consider lowering the peak reflow temperature, or reduce the time above liquidus to <60 seconds.

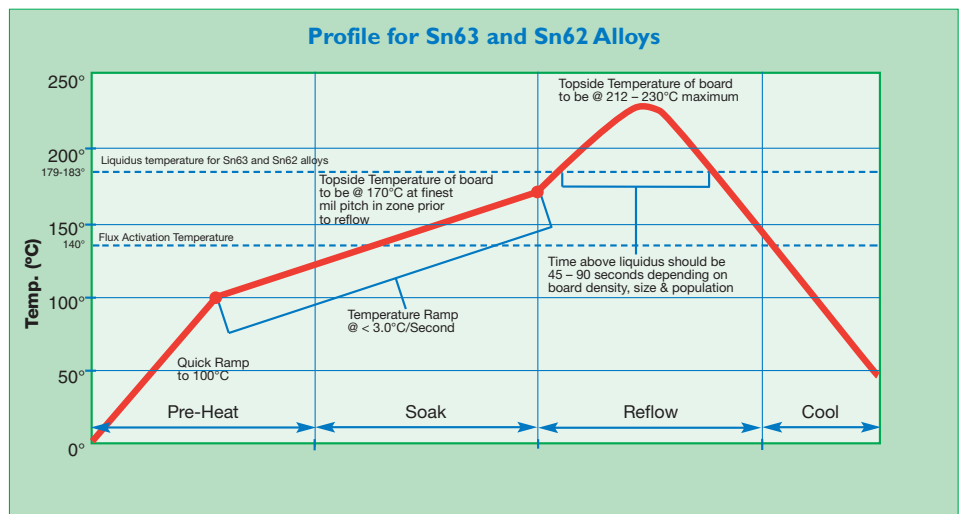
Amtech Low Oxide Powder Distribution

Micron Size	Type	Pitch Requirements
45-75µ	Type-2	24 mil and above
25-45µ	Type-3	16-24 mil
20-38µ	Type-4	12-16 mil
15-25µ	Type-5	8-12 mil
5-15µ	Type-6	5-8 mil
2-11µ	Type-7	< 5 mil

Note: Type-6 and Type-7 may not be available in certain alloys. Other powder distributions are available on request.

Storage

Solder paste should be stored between 3-8 °C (37-46 °F) to obtain the maximum refrigerated shelf life of six months. Unopened solder paste stored at room temperature, 25 °C (77 °F) will have a one month shelf life. Syringes and cartridges should be stored vertically in the refrigerator with the dispensing tip down. Allow 4-8 hours for solder paste to reach an operating temperature of 20-25 °C (68-77 °F). Keep the solder paste container sealed while warming the solder paste to operating temperature. **NEVER FREEZE SOLDER PASTE.**



**INVENTEC**

500 Main Street, Suite 18
Postfach 989
Deep River, CT 06417 USA

Gebührenfrei: 800.435.0317
Telefon: 860.526.8300
Fax: 860.526.8243
www.amtechsolder.com

RMA-223, Kolophonium, milde aktive Lötpaste

Produktdatenblatt

Produkt Highlights

- n ROL0 Flussmittelklassifizierung
- n Außergewöhnliche Druckauflösung
- n Hervorragende Benetzung auf den meisten Plattenoberflächen n
- Geringe Porenbildung
- n Lange Lebensdauer der Schablone
- n Breites Prozessfenster
- n REACH-konform
- n Kompatibel mit geschlossenen Druckköpfen
- n Lötpaste in Druck- und Dosierqualität erhältlich

Verfügbare Legierungen

	Temp. °C	Temperatur °F
	183	361
63Sn/37Pb 62Sn/	179	354
36Pb/2Ag 62,8Sn/36,8Pb/	179-183	354-361
0,4Ag 60Sn/	183-191	361-376
40Pb 43Sn/43Pb/	144-163	291-325
14Bi 42Sn/	138	280
58Bi 10Sn/88Pb/2Ag	268-290	514-554

Verpackung

500-Gramm-Gläser
700-Gramm-Kartuschen
35- oder 100-Gramm-Spritzen
ProFlow-Kassetten

Testergebnisse

Test J-STD-004 oder sonstige Voraussetzungen (wie angegeben)	Testanforderung	Ergebnis
Kupferspiegel	IPC-TM-650: 2.3.32	L: Kein Durchbruch
Korrosion	IPC-TM-650: 2.6.15	L: Keine Korrosion
Quantitative Halogenide	IPC-TM-650: 2.3.28.1	L: <0,05 %
Elektrochemische Migration	IPC-TM-650: 2.6.14.1	L: <1 Dekade Abfall (Nicht gereinigt)
Oberflächenisolationswiderstand 85 ° C, 85 % relative Luftfeuchtigkeit bei 168 Stunden	IPC-TM-650: 2.6.3.7	L: >100 M Ω (keine Reinigung)
Klebrigkeitswert	IPC-TM-650: 2.4.44	48 g
Viskosität – Malcom bei 10 U/min/25 ° C (x103 mPa/s) – Sn63/Pb37 T3/T4	IPC-TM-650: 2.4.34.4	Drucken: 200-275 Abgabe: 110-150
Visuell	IPC-TM-650: 3.4.2.5	Klar und frei durch Niederschlag
Einhaltung der Konfliktmineralien-Vorschriften	Konform mit der Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)	
REACH-Konformität	Artikel 33 und 67 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Enthält keine Substanz >0,1 % (w/w), die als SVHC aufgeführt ist oder für die Verwendung in Lötmaterialien eingeschränkt

RMA-223, Kolophonium, milde aktive Lötpaste

Druckerbetrieb

Im Folgenden finden Sie allgemeine Richtlinien zur Optimierung des Schablonendruckers mit RMA-223. Je nach Ihren Prozessanforderungen können einige Anpassungen erforderlich sein.

Druckgeschwindigkeit: 25–100 mm/s

Rakeldruck: 70–250 g/cm Klinge

Unter der Schablone abwischen: Einmal alle 10-25 Drucke, oder nach Bedarf

Schablonenleben

> 8 Stunden bei 30–45 % relativer Luftfeuchtigkeit und 20–25 ° C

~ 4 Stunden bei 45–75 % relativer Luftfeuchtigkeit und 20–25 ° C

Reinigung

RMA-223 ist eine leicht aktive Rosin-Lötpaste, die bei vielen SMT-Baugruppen auf der Platine verbleiben kann.

Für Anwendungen, die eine Reinigung erfordern, kann RMA-223 mit Flussmittelrückstandsentfernern wie Inventec Disper 607 und Disper 610 gereinigt werden.

Empfohlenes Profil

Dieses Profil dient als Ausgangspunkt für die Prozessoptimierung mit RMA-223.

Um bessere Ergebnisse bei der Hohlraumbildung zu erzielen oder die Grabsteinbildung zu reduzieren, sollten Sie eine längere Einweichzone (140–180 ° C) für 60–90 Sekunden mit einer schnellen Vorheizphase verwenden. Wenn Lötzinn vorhanden ist

Entnetzung: Erwägen Sie eine Senkung der maximalen Reflow-Temperatur oder eine Reduzierung der Zeit über Liquidus auf <60 Sekunden.

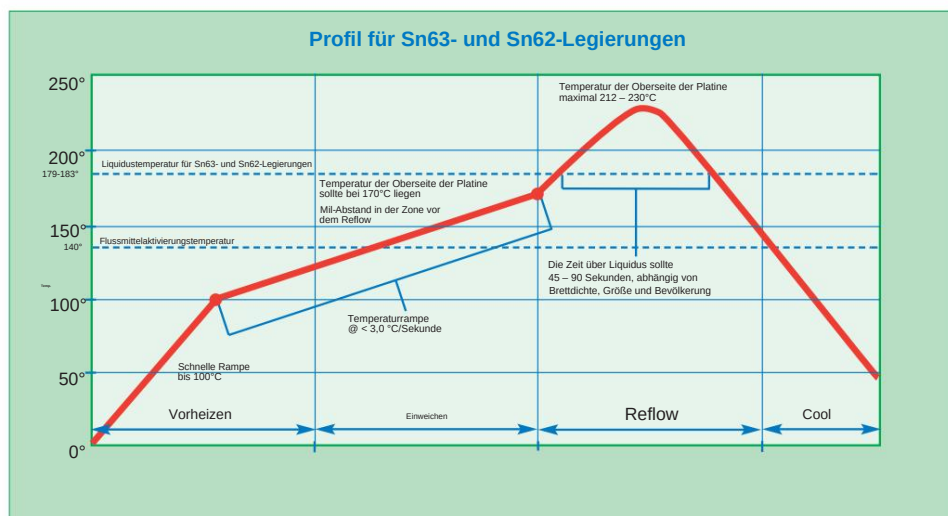
Amtech Verteilung von oxidarmen Pulvern

Mikrongröße	Typ	Stellplatzanforderungen
45-75µ	Typ 2	24 Millionen und mehr
25-45µ	Typ 3	16-24 Millionen
20-38µ	Typ 4	12-16 Millionen
15-25µ	Typ 5	8-12 Millionen
5-15µ	Typ 6	5-8 Millionen
2-11µ	Typ 7	< 5 Mio.

Hinweis: Typ 6 und Typ 7 sind in bestimmten Legierungen möglicherweise nicht verfügbar. Andere Pulververteilungen sind auf Anfrage erhältlich.

Lagerung

Lötpaste sollte bei 3–8 ° C (37–46 ° F) gelagert werden, um die maximale Haltbarkeit von sechs Monaten im Kühlschrank zu erreichen. Ungeöffnete Lötpaste ist bei Raumtemperatur (25 ° C) einen Monat haltbar. Spritzen und Kartuschen sollten senkrecht im Kühlschrank mit der Dosierspitze nach unten gelagert werden. Warten Sie 4–8 Stunden, bis die Lötpaste eine Betriebstemperatur von 20–25 ° C (68–77 ° F) erreicht hat. Halten Sie den Lötpastenbehälter während des Erwärmens der Lötpaste auf Betriebstemperatur verschlossen. **LÖTPASTE NIEMALS EINFRIEREN.**





INVENTEC

Hlavná ulica 500, apartmán 18
P. O. Box 989

Deep River, CT 06417 USA

Bezplatná linka: 800.435.0317

Telefón: 860.526.8300

Fax: 860.526.8243

www.amtechsolder.com

RMA-223, Mierne aktívna spájkovacia pasta Rosin

Produktový list

Hlavné vlastnosti produktu

Klasifikácia toku **n** ROLO

Výnimočná definícia tlače

n Výborná zmáčavosť na väčšine povrchových úprav dosiek

n Nízka tvorba pórov

n Dlhá životnosť šablóny

Široké procesné okno

V súlade s REACH

Kompatibilné s priloženými tlačovými hlavami

n K dispozícii je spájkovacia pasta na tlač a dávkovanie

Dostupné zliatiny

	Teplota °C	Teplota °F
63Sn/	183	361
37Pb 62Sn/36Pb/	179	354
2Ag 62,8Sn/36,8Pb/0,4Ag	179 – 183	354 – 361
60Sn/40Pb	183 – 191	361 – 376
43Sn/43Pb/14Bi	144 – 163	291 – 325
42Sn/58Bi	138	280
10Sn/88Pb/2Ag	268 – 290	514 – 554

Balenie

500-gramové poháre

700-gramové náplne

35 alebo 100 gramové striekačky

Kazety ProFlow

Výsledky testov

Test J-STD-004 alebo ďalšie požiadavky (ako je uvedené)	Požiadavka na test	Výsledok
Medené zrkadlo	IPC-TM-650: 2.3.32	L: Žiadny prielom
Korózia	IPC-TM-650: 2.6.15	L: Bez korózie
Kvantitatívne halogenidy	IPC-TM-650: 2.3.28.1	L: <0,05 %
Elektrochemická migrácia	IPC-TM-650: 2.6.14.1	L: Pokles o <1 dekádu (Nečistené)
Povrchový izolačný odpor 85 ° C, 85 % relatívnej vlhkosti pri 168 hodinách	IPC-TM-650: 2.6.3.7	L: 100 MΩ (bez čistenia)
Hodnota lepidlosti	IPC-TM-650: 2.4.44	48 g
Viskozita - Malcom pri 10 ot./min./25 ° C (x10 ³ mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4	IPC-TM-650: 2.4.34.4	Tlač: 200-275 Dávkovanie: 110-150
Vizuálne	IPC-TM-650: 3.4.2.5	Jasné a bezplatné zo zrážok
Súlad s predpismi o konfliktných nerastoch	V súlade s koalíciou pre občianstvo elektronického priemyslu (EICC)	
Súlad s REACH	Články 33 a 67 nariadenia (ES) č. 1907/2006	Neobsahuje žiadnu látku > 0,1 % hmotn./hmotn., ktorá je uvedená ako SVHC alebo ktorej použitie v spájkovacích materiáloch je obmedzené.

RMA-223, Mierne aktívna spájkovacia pasta Rosin

Obsluha tlačiarne

Nasledujú všeobecné pokyny pre optimalizáciu tlačiarne šablón s RMA-223. Na základe požiadaviek vášho procesu môžu byť potrebné určité úpravy.

Rýchlosť tlače: 25 – 100 mm/s

Tlak stierky: 70 – 250 g/cm stierky

Utieranie pod šablónou: Raz za 10 – 25 výťahov alebo podľa potreby

Životnosť šablóny

> 8 hodín pri 30 – 45 % relatívnej vlhkosti a 20 – 25 ° C

~ 4 hodiny pri 45 – 75 % relatívnej vlhkosti a 20 – 25 ° C

Čistenie

RMA-223 je mierne aktívna spájkovacia pasta Rosin, ktorú možno ponechať na doske pri mnohých SMT zostavách.

V aplikáciách vyžadujúcich čistenie je možné RMA-223 čistiť pomocou odstraňovačov zvyškov tavidla, ako sú Inventec Disper 607 a Disper 610.

Odporúčaný profil

Tento profil slúži ako východiskový bod pre optimalizáciu procesu pomocou RMA-223. Na dosiahnutie lepších výsledkov pri odstraňovaní dutín alebo na zníženie tvorby náhrobkov zvážte použitie dlhšej namáčacej zóny (140 – 180 ° C) počas 60 – 90 sekúnd s rýchlym predhrievaním.

Ak existujú dôkazy o spájkovaní odvlhčovanie, zvážte zníženie maximálnej teploty pretavenia alebo skráťte čas nad likvidom na <60 sekúnd.

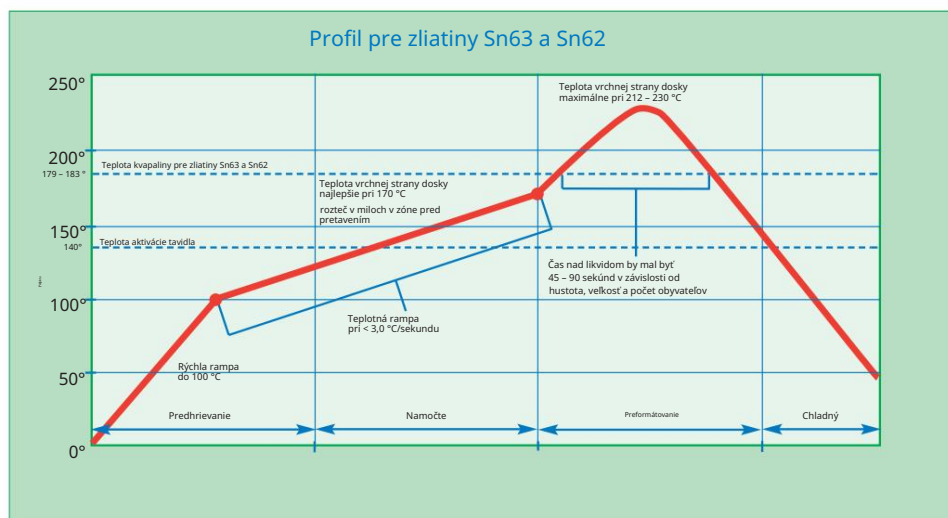
Distribúcia nízkooxidového prášku Amtech

Veľkosť v mikrónoch	Typ	Požiadavky na ihrisko
45-75μ	Typ 2	24 mil a viac
25-45μ	Typ 3	16 – 24 mil
20-38μ	Typ-4	12 – 16 mil
15-25μ	Typ-5	8-12 mil
5-15μ	Typ-6	5-8 mil
2-11μ	Typ-7	< 5 mil

Poznámka: Typ 6 a typ 7 nemusia byť dostupné v niektorých zliatinách. Iné rozloženia prášku sú k dispozícii na požiadanie.

Skladovanie

Spájkovacia pasta by sa mala skladovať pri teplote 3 – 8 ° C (37 – 46 ° F), aby sa dosiahla maximálna trvanlivosť v chladničke šesť mesiacov. Neotvorená spájkovacia pasta skladovaná pri izbovej teplote, 25 ° C (77 ° F) má trvanlivosť jeden mesiac. Striekačky a kartuše by sa mali skladovať vertikálne v chladničke s dávkovacím hrotom nadol. Nechajte 4 – 8 hodín, aby spájkovacia pasta dosiahla prevádzkovú teplotu 20 – 25 ° C (68 – 77 ° F). Počas zahrievania spájkovacej pasty na prevádzkovú teplotu udržiavajte nádobu so spájkovacou pastou uzavretú. Spájkovaciu pastu NIKDY NEZMRAZUJTE.





INVENTEC

Hlavní ulice 500, apartmá 18
P. O. Box 989
Deep River, CT 06417 USA

Bezplatná linka: 800.435.0317
Telefon: 860.526.8300
Fax: 860.526.8243
www.amtechsolder.com

RMA-223, Rosin mírně aktivní pájecí pasta

Produktový list

Hlavní vlastnosti produktu

Klasifikace toku **n** ROLO

n Výjimečná ostrost tisku

n Vynikající smáčivost na většině povrchových úprav desek

n Nízké pórovitost

n Dlouhá životnost šablony

Široké procesní okno

V souladu s nařízením REACH

n Kompatibilní s příloženými tiskovými hlavami

n K dispozici je pájecí pasta pro tisk a dávkování

Dostupné slitiny

Slitina	Teplota °C	Teplota °F
63Sn/37Pb	183	361
62Sn/36Pb/2Ag	179	354
62,8Sn/36,8Pb/0,4Ag	179-183	354-361
60Sn/40Pb	183-191	361-376
43Sn/43Pb/14Bi	144-163	291-325
42Sn/58Bi	138	280
10Sn/88Pb/2Ag	268-290	514-554

Obal

500gramové sklenice

700gramové kartuše

Stříkačky o objemu 35 nebo 100 gramů

Kazety ProFlow

Výsledky testů

Test J-STD-004 nebo další požadavky (jak je uvedeno)	Požadavek na test	Výsledek
Měděné zrcadlo	IPC-TM-650: 2.3.32	L: Žádný průlom
Koroze	IPC-TM-650: 2.6.15	L: Bez koroze
Kvantitativní halogenidy	IPC-TM-650: 2.3.28.1	L: <0,05 %
Elektrochemická migrace	IPC-TM-650: 2.6.14.1	L: Pokles o <1 dekádu (Nečištěno)
Povrchový izolační odpor 85 ° C, 85% relativní vlhkosti při 168 hodinách	IPC-TM-650: 2.6.3.7	L: 100 MΩ (bez čištění)
Hodnota lepidlosti	IPC-TM-650: 2.4.44	48 g
Viskozita - Malcom při 10 ot./min/25 ° C (x10 ³ mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4	IPC-TM-650: 2.4.34.4	Tisk: 200-275 Dávkování: 110-150
Vizuální	IPC-TM-650: 3.4.2.5	Jasně a volně ze srážek
Dodržování předpisů pro konfliktní minerály	V souladu s koalici pro občanství elektronického průmyslu (EICC)	
Soulad s nařízením REACH	Články 33 a 67 nařízení (ES) č. 1907/2006	Neobsahuje žádnou látku >0,1 % hmotn./hmotn., která je uvedena jako SVHC nebo jejíž použití v pájecích materiálech je omezeno.

RMA-223, Rosin mírně aktivní pájecí pasta

Obsluha tiskárny

Následují obecné pokyny pro optimalizaci šablonové tiskárny s RMA-223. Na základě požadavků vašeho procesu mohou být nutné určité úpravy.

Rychlost tisku: 25–100 mm/s

Tlak stěrky: 70–250 g/cm stěrky

Otírání pod šablonou: Každých 10–25 výtisků
nebo dle potřeby

Život šablony

> 8 hodin při 30–45 % relativní vlhkosti a 20–25 ° C

~ 4 hodiny při 45–75 % relativní vlhkosti a 20–25 ° C

Čištění

RMA-223 je mírně aktivní pájecí pasta Rosin, kterou lze ponechat na desce desek pro mnoho SMT sestav.

Pro aplikace vyžadující čištění lze RMA-223 čistit pomocí odstraňovačů zbytků tavidla, jako jsou Inventec Disper 607 a Disper 610.

Doporučený profil

Tento profil je navržen jako výchozí bod pro optimalizaci procesu s použitím RMA-223.

Pro dosažení lepších výsledků při odstraňování dutin nebo pro snížení tvorby náhrobků zvažte použití delší namáčecí zóny (140–180 ° C) po dobu 60–90 sekund s rychlým předehřátím.

Pokud existují známky pájení

odvlhčování, zvažte snížení maximální teploty přetavování nebo zkrátte dobu nad likvidem na <60 sekund.

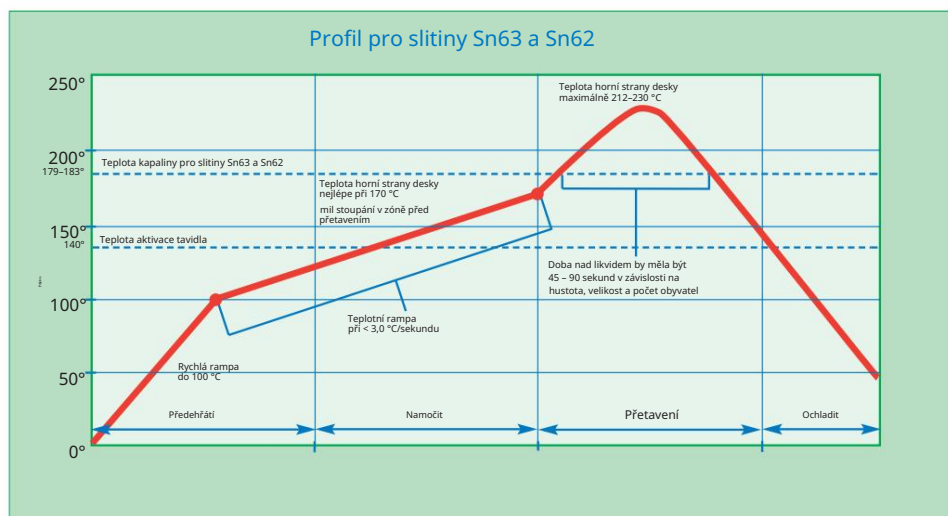
Distribuce nízkooxidových prášků Amtech

Velikost mikronů	Typ	Požadavky na hříště
45-75μ	Typ 2	24 mil a více
25-45μ	Typ-3	16–24 mil
20-38μ	Typ 4	12–16 mil
15-25μ	Typ-5	8-12 mil
5-15μ	Typ-6	5-8 mil
2-11μ	Typ-7	< 5 mil

Poznámka: Typ 6 a typ 7 nemusí být k dispozici u některých slitin. Jiné distribuce prášku jsou k dispozici na vyžádání.

Skladování

Pájecí pasta by měla být skladována při teplotě 3–8 ° C (37–46 ° F), aby se dosáhlo maximální trvanlivosti v chladničce šest měsíců. Neotevřená pájecí pasta skladovaná při pokojové teplotě, 25 ° C (77 ° F) má trvanlivost jeden měsíc. Stříkačky a kartuše by měly být skladovány svisle v chladničce s dávkovacím hrotem dolů. Nechte pájecí pastu 4–8 hodin ohřát na provozní teplotu 20–25 ° C (68–77 ° F). Během ohřívání pájecí pasty na provozní teplotu udržujte nádobu s pájecí pastou uzavřenou. PÁJECÍ PASTU NIKDY NEZMRAZUJTE.





INVENTEC

500 Main Street, 18. lakosztály
989. postafiók

Deep River, CT 06417, Amerikai Egyesült Államok

Díjmentes szám: 800.435.0317

Telefon: 860.526.8300

Fax: 860.526.8243

www.amtechsolder.com

RMA-223, Rosin enyhén aktív forrasztópaszta

Termékatlap

Termék kiemelt jellemzői

n ROLO fluxus osztályozás

Kivételes nyomtatási felbontás

n Kiváló nedvesedés a legtöbb kartonfelületen n Alacsony

páratartalom

Hosszú sablonélettartam

Széles folyamatablak

REACH - megfelelés

n Kompatibilis a zárt nyomtatófejekkel

Nyomtatásra és adagolásra alkalmas forrasztópaszta kapható

Elérhető ötvözetek

	Hőmérséklet	Hőmérséklet °F
63Sn/	183	361
37Pb 62Sn/36Pb/	179	354
2Ag 62.8Sn/36.8Pb/0.4Ag	179-183	354-361
60Sn/40Pb	183-191	361-376
43Sn/43Pb/14Bi	144-163	291-325
42Sn/58Bi	138	280
10Sn/88Pb/2Ag	268-290	514-554

Csomagolás

500 grammos üvegek

700 grammos patronok

35 vagy 100 grammos fecskendő

ProFlow kazetták

Teszteredmények

J-STD-004 teszt vagy egyéb követelmények (ahogy leírtuk)	Vizsgálati követelmény	Eredmény
Réz tűkör	IPC-TM-650: 2.3.32	L: Nincs áttörés
Korrózió	IPC-TM-650: 2.6.15	L: Nincs korrózió
Mennyiségi halogenidek	IPC-TM-650: 2.3.28.1	L: <0,05%
Elektrokémiai migráció	IPC-TM-650: 2.6.14.1	L: <1 évtizedes csökkenés (Nem tisztított)
Felületi szigetelési ellenállás 85 ° C, 85% relatív páratartalom 168 órán keresztül	IPC-TM-650: 2.6.3.7	L: 100 MΩ (tisztítás nélkül)
Tapadási érték	IPC-TM-650: 2.4.44	48 g
Viszkozitás - Malcom @ 10 RPM/25 ° C (x103 mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4	IPC-TM-650: 2.4.34.4	Nyomtatás: 200-275 Adagolás: 110-150
Vizuális	IPC-TM-650: 3.4.2.5	Tiszta és ingyenes csapadéktól
Konfliktusos ásványkincsek megfelelése	Elektronikus Ipari Polgári Koalíció (EICC) megfelel az előírásoknak	
REACH-megfelelés	A rendelet 33. és 67. cikke 1907/2006/EK rendelet	Nem tartalmaz 0,1% t/t-nál nagyobb mennyiségű, különös aggodalomra okot adó anyagként (SVHC) felsorolt vagy forrasztóanyagokban való felhasználásra korlátozott anyagot

RMA-223, Rosin enyhén aktív forrasztópaszta

Nyomtató működése

Az alábbiakban általános irányelveket talál a sablonnyomtató RMA-223-mal történő optimalizálásához. A folyamatkövetelményektől függően bizonyos módosításokra lehet szükség.

Nyomtatási sebesség: 25-100 mm/s

Lehúzónyomás: 70-250 g/cm penge

Sablon alatti törlés: 10-25 nyomatként egyszer, vagy szükség szerint

Stencil Life

> 8 óra 30-45% relatív páratartalom és 20-25 ° C mellett

~ 4 óra 45-75% relatív páratartalom és 20-25 ° C mellett

Tisztítás

Az RMA-223 egy enyhén aktív gyantás forrasztópaszta, amely számos SMT szerelvényhez a panelen hagyható.

Tisztítást igénylő alkalmazásokhoz az RMA-223 fluxusmaradvány-eltávolítókkal, például Inventec Disper 607 és Disper 610 termékekkel tisztítható.

Ajánlott profil

Ez a profil kiindulópontként szolgál az RMA-223 felhasználásával végzett folyamatoptimalizáláshoz. A jobb eredmények elérése érdekében a vödörképződéssel vagy a sírkövesedés csökkentésével érdemes hosszabb áztatási zónát (140-180 ° C) használni 60-90 másodpercig, gyors előmelegítési szakasszal. Ha forrasztásra utaló jelek vannak Nedvességmentesítés esetén érdemes lehet csökkenteni a csúcs újraáramlási hőmérsékletet, vagy csökkenteni a likvidusz feletti időt <60 másodpercre.

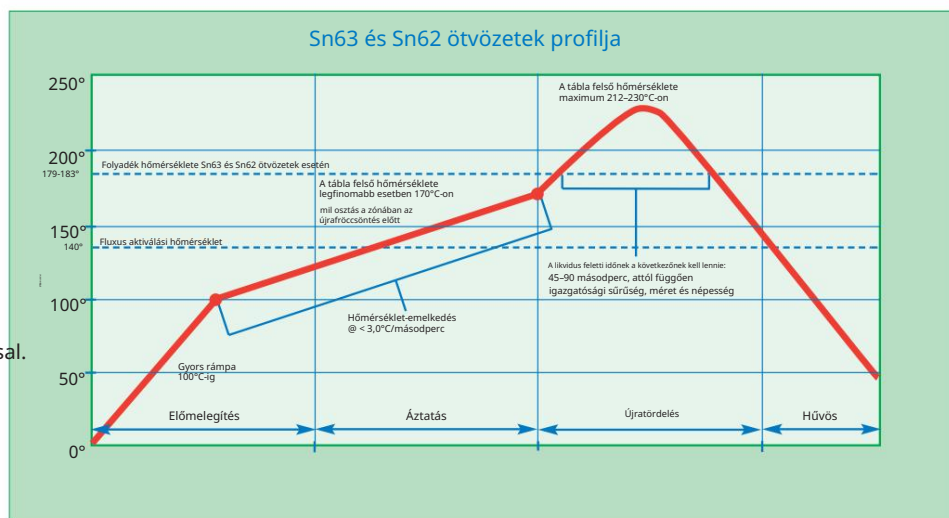
Amtech alacsony oxidtartalmú por forgalmazása

Mikron méret	Típus	Pályakövetelmények
45-75µ	2. típusú	24 millió és felette
25-45µ	3. típus	16-24 millió
20-38µ	4-es típus	12-16 millió
15-25µ	5-ös típus	8-12 millió
5-15µ	6-os típus	5-8 millió
2-11µ	7-es típus	< 5 millió

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a 6-os és 7-es típus bizonyos ötvözetekben nem érhető el. Egyéb por kísérletek kérésre elérhetők.

Tárolás

A forrasztópasztát 3-8 ° C (37-46 ° F) között kell tárolni a maximális, hat hónapos hűtőszekrényben történő eltarthatóság eléréséhez. A bontatlan forrasztópaszta szobahőmérsékleten, 25 ° C-on (77 ° F) tárolva egy hónapig eltartható. A fecskendőket és a patronokat függőlegesen, az adagolócsúccsal lefelé kell tárolni a hűtőszekrényben. Hagyjon 4-8 órát, amíg a forrasztópaszta eléri a 20-25 ° C (68-77 ° F) üzemi hőmérsékletet. A forrasztópaszta üzemi hőmérsékletre való melegítése közben tartsa lezárva a forrasztópaszta tartályát. SOHA NE FAGYASSZA LE A FORRÓPASZTÁT.





INVENTEC

Strada Principală 500, Apartamentul 18
C.P. 989

Deep River, CT 06417 SUA

Număr gratuit: 800.435.0317

Telefon: 860.526.8300

Fax: 860.526.8243

www.amtechsolder.com

RMA-223, pastă de lipit cu colofoniu ușor activ

Fișă tehnică a produsului

Caracteristici principale ale produsului

Clasificarea fluxului **n** ROLO

Definiție excepțională a **imprimării**

n Umezire excelentă pe majoritatea finisajelor de plăci **n**

Formare redusă de goluri

Durată lungă de viață a șablonului

n Fereastră largă de procesare

Conform cu REACH

Compatibil cu capetele de imprimare incluse

Pastă de lipit de calitate **pentru** imprimare și dozare disponibilă

Aliaje disponibile

Aliaj	Temperatură	Temperatură °F
63Sn/37Pb	183	361
62Sn/36Pb/2Ag	179	354
62.8Sn/36.8Pb/0.4Ag 60Sn/	179-183	354-361
40Pb 43Sn/	183-191	361-376
43Pb/14Bi 42Sn/	144-163	291-325
58Bi 10Sn/	138	280
88Pb/2Ag	268-290	514-554

Ambalaj

borcane de 500 de grame

Cartușe de 700 de grame

Seringi de 35 sau 100 de grame

Casete ProFlow

Rezultatele testelor

Testul J-STD-004 sau alte cerințe (așa cum sunt menționate)	Cerința de testare	Rezultat
Oglindă de cupru	IPC-TM-650: 2.3.32	L: Nicio descoperire
Coroziune	IPC-TM-650: 2.6.15	L: Fără coroziune
Halogenuri cantitative	IPC-TM-650: 2.3.28.1	L: <0,05%
Migrarea electrochimică	IPC-TM-650: 2.6.14.1	L: scădere <1 deceniu (Fără curățare)
Rezistență la izolația suprafeței 85 ° C, 85% umiditate relativă la 168 de ore	IPC-TM-650: 2.6.3.7	L: 100 MΩ (Fără curățare)
Valoare Tack	IPC-TM-650: 2.4.44	48g
Vâscozitate - Malcom la 10 RPM/25 ° C (x10 ³ mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4	IPC-TM-650: 2.4.34.4	Tipărire: 200-275 Distribuire: 110-150
Vizual	IPC-TM-650: 3.4.2.5	Clar și liber din precipitații
Conformitatea cu reglementările privind mineralele din conflict	Conform cu Coaliția pentru Cetățenie în Industria Electronică (EICC)	
Conformitate cu REACH	Articolele 33 și 67 din Regulament (CE) nr. 1907/2006	Nu conține substanțe >0,1% g/g care sunt listate ca SVHC sau restricționate pentru utilizare în materiale de lipit

RMA-223, pastă de lipit cu colofoniu ușor activ

Funcționarea imprimantei

Următoarele sunt instrucțiuni generale pentru optimizarea imprimantei cu șabloane cu RMA-223. Este posibil să fie necesare unele ajustări în funcție de cerințele procesului dumneavoastră.

Viteză de imprimare: 25-100 mm/sec

Presiune racletă: 70-250 g/cm de lamă

Ștergere sub șablon: O dată la 10-25 de imprimări, sau după cum este necesar

Durata de viață a șablonului

> 8 ore la 30-45% umiditate relativă și 20-25 ° C

~ 4 ore la 45-75% umiditate relativă și 20-25 ° C

Curățenie

RMA-223 este o pastă de lipit cu colofoniu ușor activ care poate fi lăsată pe placă pentru multe ansambluri SMT.

Pentru aplicațiile care necesită curățare, RMA-223 poate fi curățat folosind agenți de îndepărtare a reziduurilor de flux, cum ar fi Inventec Disper 607 și Disper 610.

Profil recomandat

Acest profil este conceput pentru a servi ca punct de plecare pentru optimizarea procesului utilizând RMA-223. Pentru a obține rezultate mai bune cu golirea sau pentru a reduce formarea de goluri, luați în considerare utilizarea unei zone de înmuiere mai lungi (140-180 ° C) timp de 60-90 de secunde, cu o etapă de preîncălzire rapidă. Dacă există dovezi de lipire

Pentru deumectare, luați în considerare scăderea temperaturii de vârf de reflux sau reduceți timpul deasupra lichidusului la <60 de secunde.

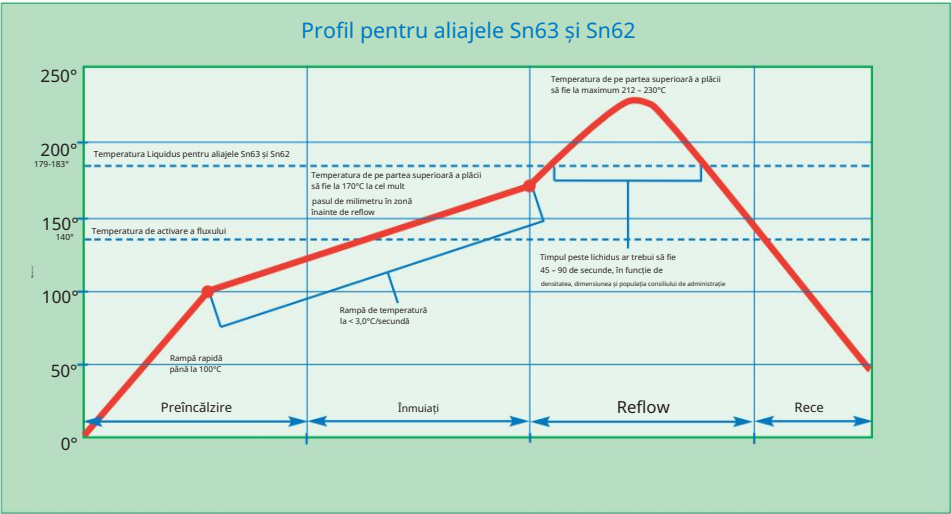
Distribuție de pulbere cu conținut scăzut de oxid Amtech

Dimensiune micron	Tip	Cerințe privind terenul de joc
45-75μ	Tipul 2	24 de milioane și peste
25-45μ	Tipul 3	16-24 milioane
20-38μ	Tipul 4	12-16 milioane
15-25μ	Tipul 5	8-12 milioane
5-15μ	Tipul 6	5-8 milioane
2-11μ	Tipul 7	< 5 milioane

Notă: Este posibil ca tipurile 6 și 7 să nu fie disponibile în anumite aliaje. Alte distribuții de pulbere sunt disponibile la cerere.

Depozitare

Pasta de lipit trebuie depozitată între 3-8 ° C (37-46 ° F) pentru a obține o durată maximă de valabilitate la frigider de șase luni. Pasta de lipit nedeschisă, depozitată la temperatura camerei, la 25 ° C (77 ° F), va avea o durată de valabilitate de o lună. Seringile și cartușele trebuie depozitate vertical în frigider, cu vârful de dozare în jos. Așteptați 4-8 ore pentru ca pasta de lipit să atingă o temperatură de funcționare de 20-25 ° C (68-77 ° F). Păstrați recipientul cu pastă de lipit sigilat în timp ce încălziți pasta de lipit la temperatura de funcționare. NU CONGELAȚI NICIODATĂ PASTĂ DE LIPIT.





INVENTEC

Glavna ulica 500, apartma 18
Poštni predal 989
Deep River, CT 06417 ZDA

Brezplačna številka: 800.435.0317
Telefon: 860.526.8300
Faks: 860.526.8243
www.amtechsolder.com

RMA-223, rahlo aktivna spajkalna pasta Rosin

Podatkovni list izdelka

Poudarki izdelka

Klasifikacija fluksa **n** ROL0

Izjemna ločljivost tiska

n Odlično omočenje na večini površinskih obdelav plošč

n Nizko praznjenje

Dolga življenjska doba šablone

n Široko procesno okno

n Skladen z REACH

n Združljivo s priloženimi tiskalnimi glavami

n Na voljo je spajkalna pasta za tiskanje in doziranje

Razpoložljive zlitine

Zlitina	Temperatura	Temperatura °F
63Sn/37Pb	183	361
62Sn/36Pb/2Ag	179	354
62,8Sn/36,8Pb/0,4Ag 60Sn/	179-183	354-361
40Pb 43Sn/	183-191	361-376
43Pb/14Bi 42Sn/	144-163	291-325
58Bi 10Sn/	138	280
88Pb/2Ag	268-290	514-554

Embalaža

500-gramski kozarci

700-gramske kartuše

35- ali 100-gramske brizge

Kasete ProFlow

Rezultati testov

Test J-STD-004 ali druge zahteve (kot je navedeno)	Zahteva za testiranje	Rezultat
Bakreno ogledalo	IPC-TM-650: 2.3.32	L: Brez preboja
Korozijska	IPC-TM-650: 2.6.15	L: Brez korozijske
Kvantitativni halogenidi	IPC-TM-650: 2.3.28.1	L: <0,05 %
Elektrokemična migracija	IPC-TM-650: 2.6.14.1	L: padec za <1 dekada (Nečiščen)
Površinska izolacijska upornost 85 ° C, 85 % relativne vlažnosti pri 168 urah	IPC-TM-650: 2.6.3.7	L: 100 MΩ (brez čiščenja)
Vrednost lepljivosti	IPC-TM-650: 2.4.44	48 g
Viskoznost - Malcom pri 10 vrt/min/25 ° C (x10 ³ mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4	IPC-TM-650: 2.4.34.4	Tisk: 200-275 Doziranje: 110-150
Vizualno	IPC-TM-650: 3.4.2.5	Jasno in brezplačno zaradi padavin
Skladnost s predpisi o konfliktnih mineralih	Skladno s Koalicijo za državljanstvo elektronske industrije (EICC)	
Skladnost z REACH	Člena 33 in 67 Uredbe (ES) št. 1907/2006	Ne vsebuje snovi > 0,1 % m/m, ki je navedena kot SVHC ali katere uporaba v spajkalnih materialih je omejena.

RMA-223, rahlo aktivna spajkalna pasta Rosin

Delovanje tiskalnika

Sledijo splošne smernice za optimizacijo tiskalnika šablon z RMA-223. Glede na zahteve vašega procesa bodo morda potrebne nekatere prilagoditve.

Hitrost tiskanja: 25–100 mm/s

Tlak strgala: 70–250 g/cm² rezila

Brisanje pod šablono: Enkrat na vsakih 10–25 odtisov ali po potrebi

Življenje šablone

> 8 ur pri 30–45 % relativne vlažnosti in 20–25 °C

~ 4 ure pri 45–75 % relativne vlažnosti in 20–25 °C

Čiščenje

RMA-223 je blago aktivna spajkalna pasta Rosin, ki jo lahko pustite na plošči pri mnogih SMT sestavih.

Za aplikacije, ki zahtevajo čiščenje, lahko RMA-223 očistite z odstranjevalci ostankov talila, kot sta Inventec Disper 607 in Disper 610.

Priporočen profil

Ta profil je zasnovan kot izhodišče za optimizacijo procesa z uporabo RMA-223. Za doseganje boljših rezultatov pri odstranjevanju praznjenja ali za zmanjšanje nabiranja prahu razmislite o uporabi daljšega območja namakanja (140–180 °C) za 60–90 sekund s hitro fazo predgrevanja.

Če obstajajo dokazi o spajkanju razvlaževanje, razmislite o znižanju najvišje temperature reflow ali skrajšajte čas nad likvidusom na <60 sekund.

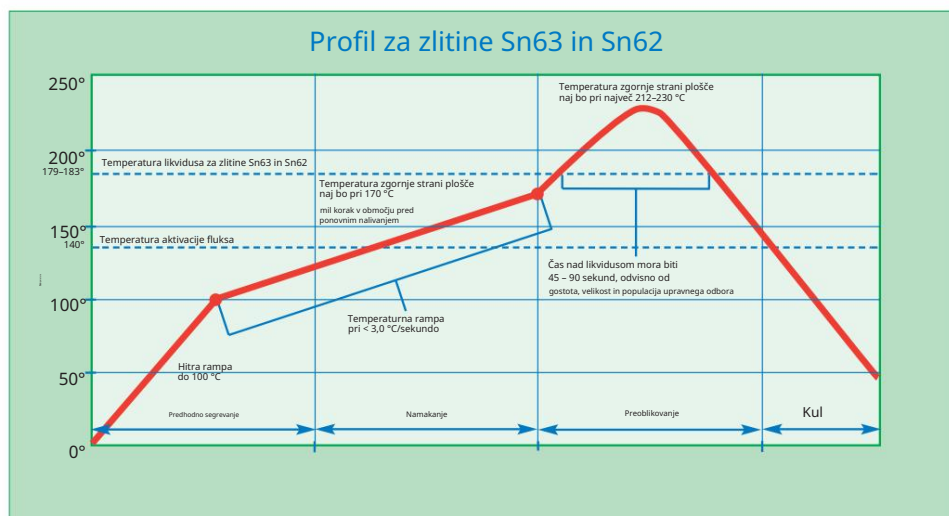
Distribucija prahu z nizko vsebnostjo oksidov Amtech

Velikost mikronov	Vrsta	Zahteve za predstavitev
45-75μ	Tip-2	24 mil in več
25-45μ	Tip-3	16–24 mil
20-38μ	Tip-4	12–16 mil
15-25μ	Tip-5	8–12 mil
5-15μ	Tip-6	5–8 mil
2-11μ	Tip-7	< 5 mil

Opomba: Tipa 6 in tip 7 morda nista na voljo v nekaterih zlitinah. Druge porazdelitve prahu so na voljo na zahtevo.

Shranjevanje

Spajkalno pasto je treba shranjevati pri temperaturi med 3 in 8 °C (37–46 °F), da se v hladilniku ohrani najdaljši rok uporabnosti šest mesecev. Neodprta spajkalna pasta, shranjena pri sobni temperaturi 25 °C (77 °F), ima en mesec uporabnosti. Brizge in kartuše je treba shranjevati navpično v hladilniku z dozirno konico navzdol. Počakajte 4–8 ur, da spajkalna pasta doseže delovno temperaturo 20–25 °C (68–77 °F). Posodo s spajkalno pasto imejte zaprto, medtem ko jo segrevate na delovno temperaturo. SPAJALNE PASTE NIKOLI NE ZAMRZUJTE.





INVENTEC

500, rue Main, bureau 18
Boîte postale 989
Deep River, CT 06417 États-Unis

Numéro gratuit : 800.435.0317
Téléphone : 860.526.8300
Télécopieur : 860.526.8243
www.amtechsolder.com

RMA-223, pâte à braser légèrement active à base de colophane

Fiche technique du produit

Points forts du produit

- n Classification des flux ROL0
- n Définition d'impression exceptionnelle
- n Excellent mouillage sur la plupart des finitions de panneaux n Faible formation de vides
- n Longue durée de vie du pochoir
- n Large fenêtre de processus
- n Conforme à REACH
- n Compatible avec les têtes d'impression fermées
- n Pâte à souder de qualité impression et distribution disponible

Alliages disponibles

Alliage	Température	Température °F
63Sn/37Pb	183	361
62Sn/36Pb/2Ag	179	354
62,8Sn/36,8Pb/0,4Ag 60Sn/	179-183	354-361
40Pb 43Sn/	183-191	361-376
43Pb/14Bi 42Sn/	144-163	291-325
58Bi 10Sn/	138	280
88Pb/2Ag	268-290	514-554

Conditionnement

pots de 500 grammes
Cartouches de 700 grammes
Seringues de 35 ou 100 grammes
Cassettes ProFlow

Résultats des tests

Test J-STD-004 ou autres exigences (comme indiqué)	Exigence de test	Résultat
Miroir en cuivre	IPC-TM-650 : 2.3.32	L : Pas de percée
Corrosion	IPC-TM-650 : 2.6.15	L : Pas de corrosion
Halogénures quantitatifs	IPC-TM-650 : 2.3.28.1	L : < 0,05 %
Migration électrochimique	IPC-TM-650 : 2.6.14.1	L : chute de < 1 décennie (Non nettoyé)
Résistance d'isolement de surface 85 °C, 85 % HR à 168 heures	IPC-TM-650 : 2.6.3.7	L : ≥ 100 MΩ (sans nettoyage)
Valeur de l'attache	IPC-TM-650 : 2.4.44	48 g
Viscosité - Malcom à 10 tr/min/25 °C (x103 mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4	IPC-TM-650 : 2.4.34.4	Tirage : 200-275 Distribution : 110-150
Visuel	IPC-TM-650 : 3.4.2.5	Clair et gratuit des précipitations
Conformité aux réglementations sur les minéraux de conflit	Conforme à la Coalition pour la citoyenneté de l'industrie électronique (EICC)	
Conformité REACH	Articles 33 et 67 du règlement (CE) n° 1907/2006	Ne contient aucune substance > 0,1 % p/p répertoriée comme SVHC ou dont l'utilisation est restreinte dans les matériaux de soudure

RMA-223, pâte à braser légèrement active à base de colophane

Fonctionnement de l'imprimante

Voici quelques conseils généraux pour l'optimisation de votre imprimante à pochoirs avec la RMA-223. Certains ajustements peuvent être nécessaires en fonction des exigences de votre processus.

Vitesse d'impression : 25-100 mm/sec

Pression de la raclette : 70-250 g/cm de lame

Sous le pochoir : une fois toutes les 10 à 25 impressions, ou si nécessaire

La vie au pochoir

> 8 heures à 30-45 % HR et 20-25 °C

~ 4 heures à 45-75 % HR et 20-25 °C

Nettoyage

RMA-223 est une pâte à souder à base de colophane légèrement active qui peut être laissée sur la carte pour de nombreux assemblages SMT.

Pour les applications nécessitant un nettoyage, le RMA-223 peut être nettoyé à l'aide de produits anti-résidus de flux tels que Inventec Disper 607 et Disper 610.

Profil recommandé

Ce profil est conçu pour servir de point de départ à l'optimisation du procédé avec le RMA-223. Pour obtenir de meilleurs résultats en termes de vide ou de réduction de l'effet de désagrégation, envisagez d'utiliser une zone de trempage plus longue (140-180 °C) pendant 60 à 90 secondes, avec une phase de préchauffage rapide. S'il y a des traces de soudure démoillage, envisagez de réduire la température de refusion maximale ou réduisez le temps au-dessus du liquidus à < 60 secondes.

Distribution de poudre à faible teneur en oxyde Amtech

Taille du micron	Taper	Exigences relatives au pitch
45-75µ	Type 2	24 millions et plus
25-45µ	Type 3	16 à 24 millions
20-38µ	Type 4	12 à 16 millions
15-25µ	Type 5	8 à 12 millions
5-15µ	Type 6	5 à 8 millions
2-11µ	Type 7	< 5 millions

Remarque : les types 6 et 7 peuvent ne pas être disponibles dans certains alliages. D'autres distributions de poudre sont disponibles sur demande.

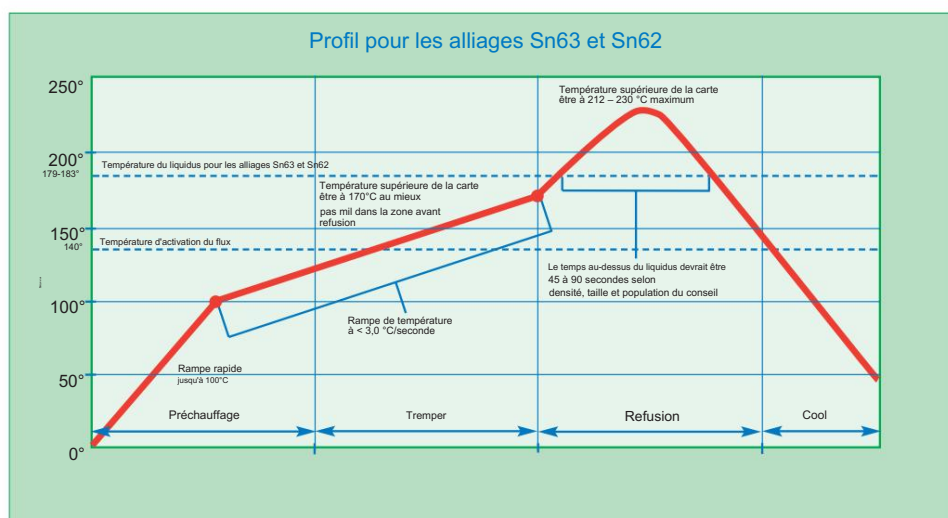
Stockage

La pâte à braser doit être conservée entre 3 et 8 °C (37 et 46 °F) pour une durée de conservation maximale au réfrigérateur de six mois.

Une pâte à braser non ouverte, conservée à température ambiante (25 °C), se conserve un mois. Les seringues et les cartouches doivent être conservées verticalement au réfrigérateur, embout vers le bas.

Comptez 4 à 8 heures pour que la pâte à braser atteigne une température de fonctionnement de 20 à 25 °C (68 à 77 °F).

Maintenez le récipient de pâte à braser fermé pendant le réchauffement de la pâte à braser. NE JAMAIS CONGELER LA PÂTE À SOUDER.





INVENTEC

Glavna ulica 500, apartman 18

Poštanski pretnac 989

Deep River, CT 06417 SAD

Besplatni broj: 800.435.0317

Telefon: 860.526.8300

Faks: 860.526.8243

www.amtechsolder.com

RMA-223, blago aktivna pasta za lemljenje na bazi kolofonija

Podatkovni list proizvoda

Najvažnije značajke proizvoda

Klasifikacija fluksa **ROL0**

Iznimna definicija ispisa

n Izvrsno kvašenje na većini završnih obrada ploča n

Nisko stvaranje šupljina

Dug vijek trajanja šablone

Široki prozor procesa

U skladu s REACH-om

n Kompatibilno s priloženim glavama za ispis

n Dostupna je pasta za lemljenje kvalitete za ispis i nanošenje

Dostupne legure

Legura	Temperatura	Temperatura °F
63Sn/37Pb	183	361
62Sn/36Pb/2Ag	179	354
62.8Sn/36.8Pb/0.4Ag 60Sn/	179-183	354-361
40Pb 43Sn/	183-191	361-376
43Pb/14Bi 42Sn/58Bi	144-163	291-325
10Sn/88Pb/	138	280
2Ag	268-290	514-554

Pakiranje

Staklenke od 500 grama

patrone od 700 grama

Šprice od 35 ili 100 grama

ProFlow kasete

Rezultati testa

Test J-STD-004 ili ostali zahtjevi (kao što je navedeno)	Zahtjev za testiranje	Proizlaziti
Bakreno ogledalo	IPC-TM-650: 2.3.32	L: Nema proboja
Korozija	IPC-TM-650: 2.6.15	L: Bez korozije
Kvantitativni halogenidi	IPC-TM-650: 2.3.28.1	L: <0,05%
Elektrokemijska migracija	IPC-TM-650: 2.6.14.1	L: Pad za <1 desetljeće (Nije očišćen)
Površinski izolacijski otpor 85 ° C, 85% relativne vlažnosti @ 168 sati	IPC-TM-650: 2.6.3.7	L: 100 MΩ (bez čišćenja)
Vrijednost ljepljivosti	IPC-TM-650: 2.4.44	48 g
Viskoznost - Malcom @ 10 RPM/25 ° C (x10 ³ mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4	IPC-TM-650: 2.4.34.4	Tisak: 200-275 Doziranje: 110-150
Vizualno	IPC-TM-650: 3.4.2.5	Jasno i besplatno od oborina
Usklađenost s propisima o konfliktim mineralima	U skladu s Koalicijom za građansko pravo elektroničke industrije (EICC)	
Usklađenost s REACH-om	Članci 33. i 67. Uredbe (EZ) br. 1907/2006	Ne sadrži tvari >0,1% w/w koje su navedene kao SVHC ili su ograničene za upotrebu u materijalima za lemljenje

RMA-223, blago aktivna pasta za lemljenje na bazi kolofonija

Rad pisača

Slijede opće smjernice za optimizaciju matricnog pisača s RMA-223. Moguće su neke prilagodbe na temelju vaših procesnih zahtjeva.

Brzina ispisa: 25-100 mm/s

Pritisak gumene špatule: 70-250 g/cm² lopatice

Brisanje ispod šablona: Jednom svakih 10-25 ispisa, ili po potrebi

Život šablone

> 8 sati pri 30-45% relativne vlažnosti i 20-25 ° C

~ 4 sata pri 45-75% relativne vlažnosti i 20-25 ° C

Čišćenje

RMA-223 je blago aktivna pasta za lemljenje Rosin koja se može ostaviti na ploči za mnoge SMT sklopove.

Za primjene koje zahtijevaju čišćenje, RMA-223 se može očistiti sredstvima za uklanjanje ostataka fluksa kao što su Inventec Disper 607 i Disper 610.

Preporučeni profil

Ovaj profil je osmišljen kao početna točka za optimizaciju procesa korištenjem RMA-223. Za postizanje boljih rezultata s uklanjanjem šupljina ili smanjenjem nakupljanja kamenca, razmislite o korištenju dulje zone namakanja (140-180 ° C) tijekom 60-90 sekundi, s brzim predgrijavanjem. Ako postoje dokazi lemljenja odvlaživanje, razmotrite snižavanje vršne temperature reflow-a ili smanjite vrijeme iznad likvidusa na <60 sekundi.

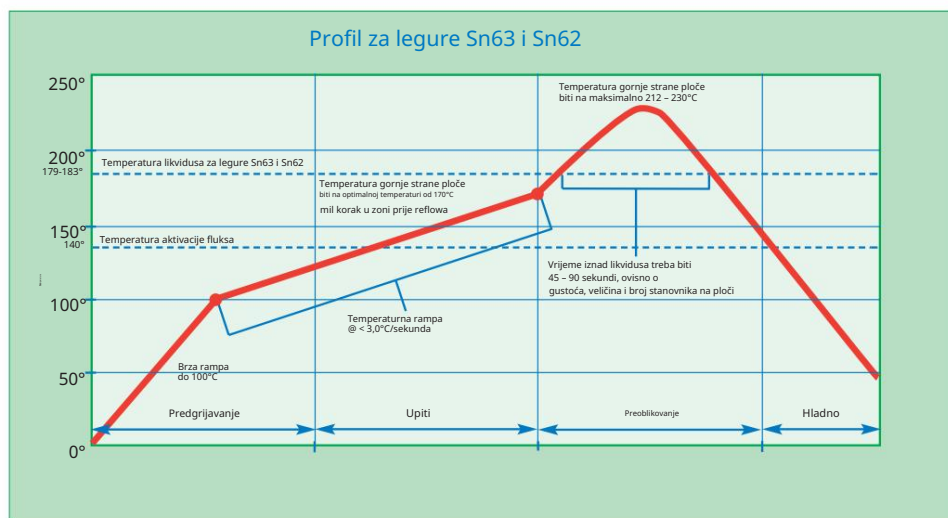
Amtechova distribucija praha s niskim udjelom oksida

Veličina mikrona	Tip	Zahtjevi za prezentaciju
45-75μ	Tip-2	24 mil i više
25-45μ	Tip-3	16-24 mil
20-38μ	Tip-4	12-16 mil
15-25μ	Tip-5	8-12 mil
5-15μ	Tip-6	5-8 mil
2-11μ	Tip-7	< 5 mil

Napomena: Tip-6 i tip-7 možda nisu dostupni u određenim legurama. Druge distribucije praha dostupne su na zahtjev.

Pohrana

Lemnu pastu treba čuvati na temperaturi od 3-8 ° C (37-46 ° F) kako bi se postigao maksimalni rok trajanja u hladnjaku od šest mjeseci. Neotvorena lemnna pasta pohranjena na sobnoj temperaturi, 25 ° C (77 ° F) imat će rok trajanja od mjesec dana. Štrcaljke i patrone treba čuvati okomito u hladnjaku s vrhom za doziranje prema dolje. Ostavite 4-8 sati da lemnna pasta dostigne radnu temperaturu od 20-25 ° C (68-77 ° F). Držite spremnik s lemnom pastom zatvoren dok zagrijavate lemnu pastu na radnu temperaturu. NIKADA NE ZAMRZAVAJTE LEMNU PASTU.





INVENTEC

500 Main Street, Σουίτα 18

Ταχυδρομική Θυρίδα 989

Ντιπ Ρίβερ, Κονέκτικατ 06417 ΗΠΑ

Δωρεάν κλήση: 800.435.0317

Τηλέφωνο: 860.526.8300

Φαξ: 860.526.8243

www.amtechsolder.com

RMA-223, Κόλλα συγκόλλησης με ήπια ενεργή ρητίνη Rosin

Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος

Κύρια σημεία προϊόντος

- Ταξινόμηση ροής ROL0
 - Εξαιρετική ευκρίνεια εκτύπωσης
 - Εξαιρετική διαβροχή στα περισσότερα φινιρίσματα σανίδας
 - Χαμηλή διαβροχή
 - Μεγάλη διάρκεια ζωής στένσιλ
 - Ευρύ παράθυρο διεργασίας
 - Συμμορφώνεται με το πρότυπο REACH
 - Συμβατό με τις εσώκλειστες κεφαλές εκτύπωσης
- Διατίθεται πάστα συγκόλλησης ποιότητας εκτύπωσης και **διανομής**

Διαθέσιμα κράματα

Κράμα	Θερμοκρασία	Θερμοκρασία °F
63Sn/37Pb	183	361
62Sn/36Pb/2Ag	179	354
62.8Sn/36.8Pb/0.4Ag 60Sn/	179-183	354-361
40Pb 43Sn/	183-191	361-376
43Pb/14Bi 42Sn/58Bi	144-163	291-325
10Sn/88Pb/	138	280
2Ag	268-290	514-554

Συσκευασία

Βάζα των 500 γραμμαρίων

Φυσίγγια 700 γραμμαρίων

Σύριγγες των 35 ή 100 γραμμαρίων

Κασέτες ProFlow

Αποτελέσματα δοκιμών

Δοκιμή J-STD-004 ή άλλες απαιτήσεις (όπως αναφέρονται)	Απαιτήση δοκιμής	Αποτέλεσμα
Χάλκινος καθρέφτης	IPC-TM-650: 2.3.32	Λ: Καμία σημαντική ανακάλυψη
Διάβρωση	IPC-TM-650: 2.6.15	Λ: Καμία διάβρωση
Ποσοτικά αλογονίδια	IPC-TM-650: 2.3.28.1	L: <0,05%
Ηλεκτροχημική Μετανάστευση	IPC-TM-650: 2.6.14.1	L: <1 δεκαετία πτώσης (Χωρίς καθάρισμα)
Αντίσταση μόνωσης επιφάνειας 85 ο C, 85% σχετική υγρασία @ 168 ώρες	IPC-TM-650: 2.6.3.7	L: 100 MΩ (Χωρίς καθαρισμό)
Αξία πρόσδεσης	IPC-TM-650: 2.4.44	48 γρ.
Ιξώδες - Malcom @ 10 RPM/25 ο C (x103 mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4	IPC-TM-650: 2.4.34.4	Εκτύπωση: 200-275 Χορήγηση: 110-150
Οπτικός	IPC-TM-650: 3.4.2.5	Καθαρό και δωρεάν από τις βροχοπτώσεις
Συμμόρφωση με τα Ορυκτά Συγκρούσεων	Συμμόρφωση με τον Συνασπισμό Ιθαγένειας Ηλεκτρονικής Βιομηχανίας (EICC)	
Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH	Άρθρα 33 και 67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006	Δεν περιέχει ουσία >0,1% w/w που να αναφέρεται ως SVHC ή να έχει περιορισμένη χρήση σε υλικά συγκόλλησης.

RMA-223, Κόλλα συγκόλλησης με ήπια ενεργή ρητίνη Rosin

Λειτουργία εκτυπωτή

Ακολουθούν γενικές οδηγίες για τη βελτιστοποίηση του εκτυπωτή στένσιλ με το RMA-223. Ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένες προσαρμογές ανάλογα με τις απαιτήσεις της διεργασίας σας.

Ταχύτητα εκτύπωσης: 25-100 mm/δευτ.

Πίεση λάμας: 70-250g/cm λεπίδας

Κάτω από το στένσιλ: Μία φορά κάθε 10-25 εκτυπώσεις, ή όπως απαιτείται

Στένσιλ Ζωή

> 8 ώρες @ 30-45% σχετική υγρασία και 20-25 °C

~ 4 ώρες @ 45-75% σχετική υγρασία και 20-25 °C

Καθάρισμα

Το RMA-223 είναι μια πάστα συγκόλλησης Rosin Mildly Active που μπορεί να παραμείνει στην πλακέτα για πολλά συγκροτήματα SMT.

Για εφαρμογές που απαιτούν καθαρισμό, το RMA-223 μπορεί να καθαριστεί χρησιμοποιώντας προϊόντα αφαίρεσης υπολειμμάτων ροής όπως το Inventec Disper 607 και το Disper 610.

Προτεινόμενο προφίλ

Αυτό το προφίλ έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιήσει ως σημείο εκκίνησης για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας χρησιμοποιώντας το RMA-223. Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα με την κενοποίηση ή για να μειώσετε την αστοχία, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης μιας μεγαλύτερης ζώνης εμποτισμού (140-180 °C) για 60-90 δευτερόλεπτα, με στάδιο ταχείας προθέρμανσης. Εάν υπάρχουν ενδείξεις συγκόλλησης για την απούγκραση, εξετάστε το ενδεχόμενο μείωσης της μέγιστης θερμοκρασίας επαναρροής ή μειώστε τον χρόνο πάνω από το liquidus σε <60 δευτερόλεπτα.

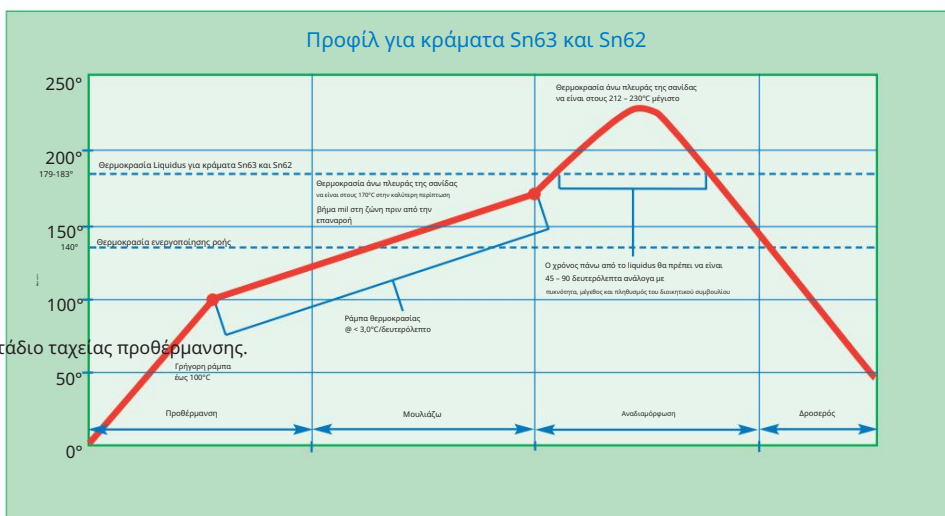
Διανομή σκόνης χαμηλού οξειδίου Amtech

Μέγεθος Μικρού	Τύπος	Απαιτήσεις γηπέδου
45-75μ	Τύπος-2	24 εκατομμύρια και άνω
25-45μ	Τύπος-3	16-24 εκατομμύρια
20-38μ	Τύπος-4	12-16 εκατομμύρια
15-25μ	Τύπος-5	8-12 εκατομμύρια
5-15μ	Τύπος-6	5-8 εκατομμύρια
2-11μ	Τύπος-7	< 5 εκατομμύρια

Σημείωση: Οι τύποι 6 και 7 ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι σε ορισμένα κράματα. Άλλες διανομές σκόνης είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

Αποθήκευση

Η πάστα συγκόλλησης πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 3-8 °C (37-46 °F) για μέγιστη διάρκεια ζωής στο ψυγείο, έξι μήνες. Η κλειστή πάστα συγκόλλησης που φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στους 25 °C (77 °F) έχει διάρκεια ζωής ενός μήνα. Οι σύριγγες και τα ψυγίγια πρέπει να φυλάσσονται κάθετα στο ψυγείο με το άκρο διανομής προς τα κάτω. Αφήστε 4-8 ώρες για να φτάσει η πάστα συγκόλλησης σε θερμοκρασία λειτουργίας 20-25 °C (68-77 °F). Διατηρήστε το δοχείο της πάστας συγκόλλησης σφραγισμένο ενώ θερμαίνετε την πάστα συγκόλλησης σε θερμοκρασία λειτουργίας. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΣΤΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ.





INVENTEC

500 Main Street, Apartment 18
Skrytka pocztowa 989
Deep River, CT 06417 USA

Bezpłatny numer: 800.435.0317
Telefon: 860.526.8300
Faks: 860.526.8243
www.amtechsolder.com

RMA-223, pasta lutownicza Rosin Mildly Active

Karta danych produktu

Najważniejsze cechy produktu

- n Klasyfikacja strumienia ROLO
- n Wyjątkowa rozdzielczość wydruku
- n Doskonałe zwilżanie większości wykończeń płyt n Niskie tworzenie się pustych przestrzeni
- n Długa żywotność szablonu
- n Szerokie okno procesowe
- n Zgodność z REACH
- n Kompatybilny z zamkniętymi głowicami drukującymi
- n Dostępna pasta lutownicza do druku i dozowania

Dostępne stopy

Stop	Temperatura	Temperatura °F
63Sn/37Pb	183	361
62Sn/36Pb/2Ag	179	354
62,8Sn/36,8Pb/0,4Ag 60Sn/	179-183	354-361
40Pb 43Sn/	183-191	361-376
43Pb/14Bi 42Sn/	144-163	291-325
58Bi 10Sn/	138	280
88Pb/2Ag	268-290	514-554

Opakowanie

Słoiki 500 gramowe
Wkłady 700 gramowe
Strzykawkki 35 lub 100 gramów
Kasety ProFlow

Wyniki testów

Test J-STD-004 lub inne wymagania (jak podano)	Wymagania testowe	Wynik
Lustro miedziane	IPC-TM-650: 2.3.32	L: Brak przełomu
Korożja	IPC-TM-650: 2.6.15	L: Brak korożji
Halogenki ilościowe	IPC-TM-650: 2.3.28.1	D: <0,05%
Migracja elektrochemiczna	IPC-TM-650: 2.6.14.1	L: <1 dekada spadku (Nie-czyszczzone)
Rezystancja izolacji powierzchniowej 85 o C, 85% wilgotności względnej po 168 godzinach	IPC-TM-650: 2.6.3.7	L: 100 MΩ (bez czyszczenia)
Wartość tackowa	IPC-TM-650: 2.4.44	48g
Lepkość - Malcom @ 10 obr./min/25 o C (x103 mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4	IPC-TM-650: 2.4.34.4	Wydruk: 200-275 Dozowanie: 110-150
Wizualny	IPC-TM-650: 3.4.2.5	Jasne i darmowe z opadów atmosferycznych
Zgodność z przepisami dotyczącymi minerałów konfliktowych	Zgodność z Koalicją Obywatelstwa Przemysłu Elektronicznego (EICC)	
Zgodność z REACH	Artykuły 33 i 67 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006	Nie zawiera substancji >0,1% w/w, która jest wymieniona jako SVHC lub której stosowanie w materiałach lutowniczych jest ograniczone

RMA-223, pasta lutownicza Rosin Mildly Active

Obsługa drukarki

Poniżej znajdują się ogólne wytyczne dotyczące optymalizacji drukarki szablonowej z RMA-223. W zależności od wymagań procesu, konieczne mogą być pewne modyfikacje.

Prędkość drukowania: 25-100 mm/sek.

Nacisk ściągaczki: 70-250 g/cm ostrza

Czyszczenie pod szablonem: Raz na 10-25 wydruków, lub w razie potrzeby

Życie szablony

> 8 godzin przy wilgotności względnej 30-45% i temperaturze 20-25 ° C

~ 4 godziny przy wilgotności względnej 45-75% i temperaturze 20-25 ° C

Czyszczenie

RMA-223 to pasta lutownicza Rosin Mildly Active, którą można pozostawić na płycie w przypadku wielu montażu SMT.

W przypadku zastosowań wymagających czyszczenia, RMA-223 można czyścić za pomocą środków do usuwania pozostałości topnika, takich jak Inventec Disper 607 i Disper 610.

Zalecany profil

Ten profil ma służyć jako punkt wyjścia do optymalizacji procesu z wykorzystaniem RMA-223. Aby uzyskać lepsze rezultaty w zakresie tworzenia pustych przestrzeni lub ograniczyć powstawanie osadów nagrobkowych, należy rozważyć zastosowanie dłuższej strefy moczenia (140-180 ° C) przez 60-90 sekund z szybkim etapem nagrzewania wstępnego. Jeśli są ślady lutowania

w celu odwilżenia, należy rozważyć obniżenie szczytowej temperatury rozplwy lub skrócenie czasu powyżej temperatury likwidus do <60 sekund.

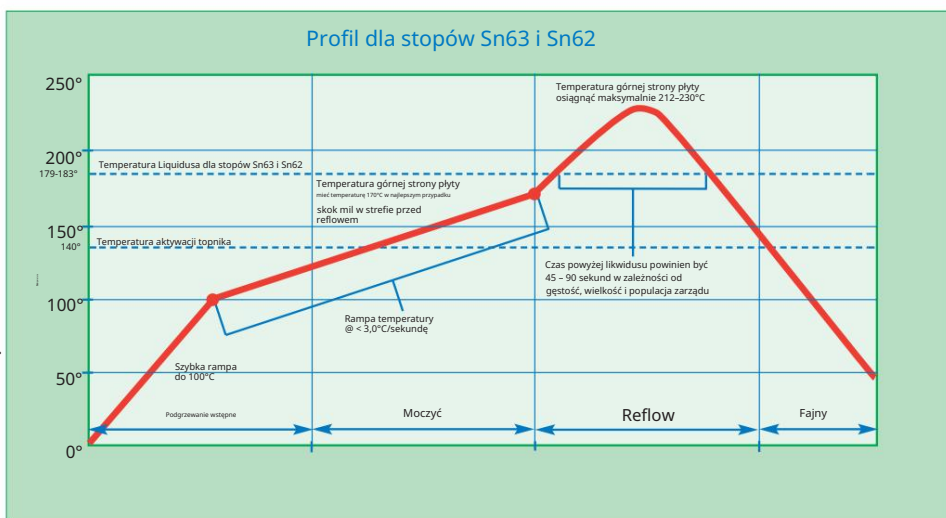
Dystrybucja proszku Amtech Low Oxide

Rozmiar mikronów	Typ	Wymagania dotyczące boiska
45-75µ	Typ 2	24 miliony i więcej
25-45µ	Typ 3	16-24 mil
20-38µ	Typ 4	12-16 mil
15-25µ	Typ 5	8-12 mil
5-15µ	Typ-6	5-8 mil
2-11µ	Typ-7	< 5 mil

Uwaga: Stopy typu 6 i 7 mogą być niedostępne w przypadku niektórych stopów. Inne rozkłady proszku są dostępne na życzenie.

Składowanie

Pastę lutowniczą należy przechowywać w temperaturze 3-8 ° C (37-46 ° F), aby uzyskać maksymalny okres przydatności do użycia w lodówce wynoszący sześć miesięcy. Nieotwarta pasta lutownicza przechowywana w temperaturze pokojowej, 25 ° C (77 ° F) będzie miała miesięczny okres przydatności do użycia. Strzykawki i wkłady należy przechowywać w lodówce w pozycji pionowej, z końcówką dozującą skierowaną w dół. Odczekać 4-8 godzin, aż pasta lutownicza osiągnie temperaturę roboczą 20-25 ° C (68-77 ° F). Pojemnik z pastą lutowniczą powinien być szczelnie zamknięty podczas podgrzewania pasty do temperatury roboczej. **NIGDY NIE ZAMRAŻAĆ PASTY LUTOWNICZEJ.**





ИНВЕНТЕК

500 Мейн Стрийт, апартамент 18
Пощенска кутия 989

Дийп Ривър, Кънектикът 06417 САЩ

Безплатен телефон: 800.435.0317

Телефон: 860.526.8300

Факс: 860.526.8243

www.amtechsolder.com

RMA-223, Слабоактивна паста за запояване на базата на колофон

Информационен лист за продукта

Акценти на продукта

Класификация на потока n ROL0

n Изключителна разделителна способност на печата

n Отлично омокряне върху повечето видове повърхности на плоскостите n

Ниско кухообразуване

n Дълъг живот на шаблона

n Широко прозорец на процеса

Съответства на REACH

n Съвместим с приложените печатащи глави

n Предлага се спояваща паста с качество за печат и дозиране

Налични сплави

Сплав	Температура	Температура °F
63Sn/37Pb	183	361
62Sn/36Pb/2Ag	179	354
62.8Sn/36.8Pb/0.4Ag 60Sn/	179-183	354-361
40Pb 43Sn/	183-191	361-376
43Pb/14Bi 42Sn/58Bi	144-163	291-325
10Sn/88Pb/	138	280
2Ag	268-290	514-554

Опаковка

буркани от 500 грама

700-грамови патрони

Спринцовки от 35 или 100 грама

Касети ProFlow

Резултати от теста

Тест J-STD-004 или други изисквания (както е посочено)	Изискване за тест	Резултат
Медно огледало	IPC-TM-650: 2.3.32	Л: Няма пробив
Корозия	IPC-TM-650: 2.6.15	Л: Без корозия
Количествени халиди	IPC-TM-650: 2.3.28.1	Л: <0,05%
Електрохимична миграция	IPC-TM-650: 2.6.14.1	Л: спад <1 десетилетие (Непочистено)
Съпротивление на повърхностната изолация 85 ° C, 85% относителна влажност @ 168 часа	IPC-TM-650: 2.6.3.7	Л: 100 MΩ (без почистване)
Стойност на лепкавостта	IPC-TM-650: 2.4.44	48 г
Вискозитет - Malcom @ 10 RPM/25 о C (x10 ³ mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4	IPC-TM-650: 2.4.34.4	Печат: 200-275 Дозиране: 110-150
Визуално	IPC-TM-650: 3.4.2.5	Ясно и безплатно от валежите
Съответствие с изискванията за конфликтни минерали	Съответства на изискванията на Коалицията за гражданство на електронната индустрия (EICC)	
Съответствие с REACH	Членове 33 и 67 от Регламента (EO) № 1907/2006	Не съдържа вещество >0,1% w/w, което е посочено като SVHC или е ограничено за употреба в спояващи материали.

RMA-223, Слабоактивна паста за запояване на базата на колофон

Работа с принтера

Следните са общи насоки за оптимизиране на шаблонен принтер с

RMA-223. Може да са необходими някои корекции въз основа

на изискванията на вашия процес.

Скорост на печат: 25-100 мм/сек

Налягане на гумената шпатула: 70-250 г/см² на острието

Избърсване под шаблон: Веднъж на всеки 10-25 разпечатки, или при необходимост

Живот на шаблона

> 8 часа при 30-45% относителна влажност и 20-25 ° C

~ 4 часа при 45-75% относителна влажност и 20-25 ° C

Почистване

RMA-223 е умерено активна спояваща паста Rosin, която може да се остави върху платката за много SMT сглобки.

За приложения, изискващи почистване, RMA-223 може да се почисти с препарати за отстраняване на остатъци от флюс, като например Inventec Disper 607 и Disper 610.

Препоръчителен профил

Този профил е предназначен да служи като отправна точка за оптимизиране на процеса с помощта на RMA-223. За да постигнете по-добри резултати при отстраняване на кухини или за да намалите образуването на надгробни камъни, помислете за използване на по-дълга зона на наkisване (140-180 ° C) за 60-90 секунди, с бърз етап на предварително нагриване. Ако има следи от спойка обезвлажняване, помислете за понижаване на пиковата температура на претопяване или намалете времето над ликвидус до <60 секунди.

Разпределение на нискооксиден прах Amtech

Размер на микрона	Тип	Изисквания за терена
45-75μ	Тип-2	24 мили и повече
25-45μ	Тип-3	16-24 мили
20-38μ	Тип-4	12-16 мили
15-25μ	Тип-5	8-12 мили
5-15μ	Тип-6	5-8 мили
2-11μ	Тип-7	< 5 мили

Забележка: Тип-6 и Тип-7 може да не са налични в някои сплави.

Други разпределения на праха се предлагат при поискване.

Съхранение

Пастата за спойка трябва да се съхранява между 3-8 ° C (37-46 ° F), за да се постигне максимален срок на годност в хладилник от шест месеца. Неотворена паста за спойка, съхранявана на стайна температура (25 ° C), ще има срок на годност от един месец. Спринцовките и патроните трябва да се съхраняват вертикално в хладилник с дозирания накрайник надолу. Оставете 4-8 часа, за да достигне пастата работна температура от 20-25 ° C (68-77 ° F). Дръжте контейнера със пастата затворен, докато я затопляте до работна температура. НИКОГА НЕ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ ПАСТАТА ЗА ПОПЯВАНЕ.

